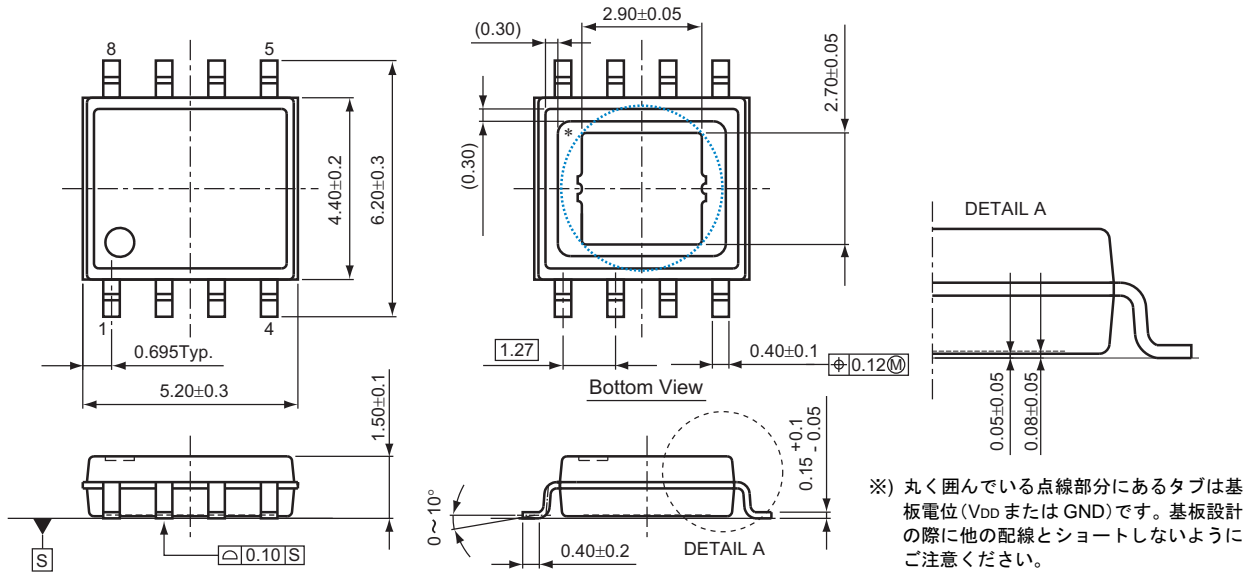


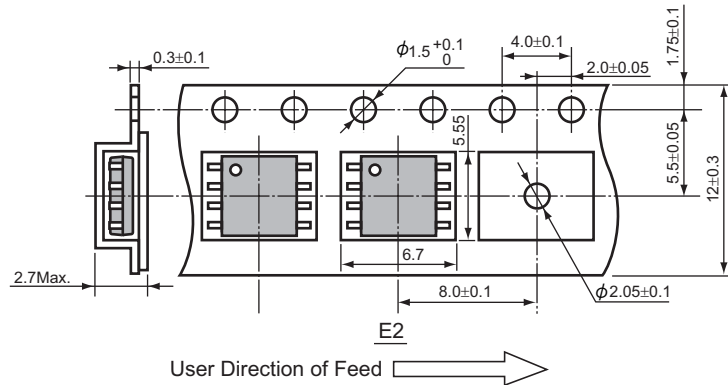
HSOP-8E

単位: mm

■ パッケージ外形図

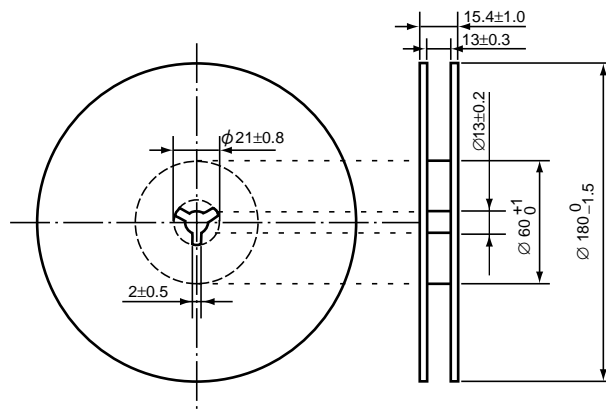


■ テーピング仕様



■ テーピングリール外形図 リュースリール(EIAJ-RRM-12Bc)

(1リール=1,000個)



■ 許容損失について (HSOP-8E)

HSOP-8Eパッケージの許容損失について特性例を示します。

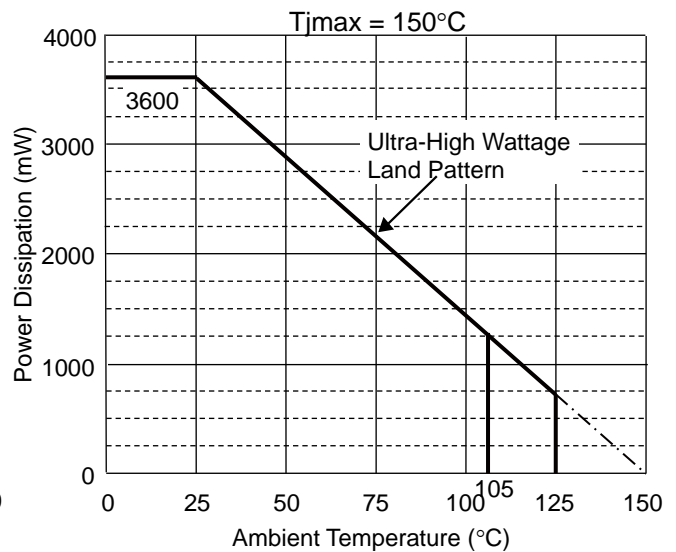
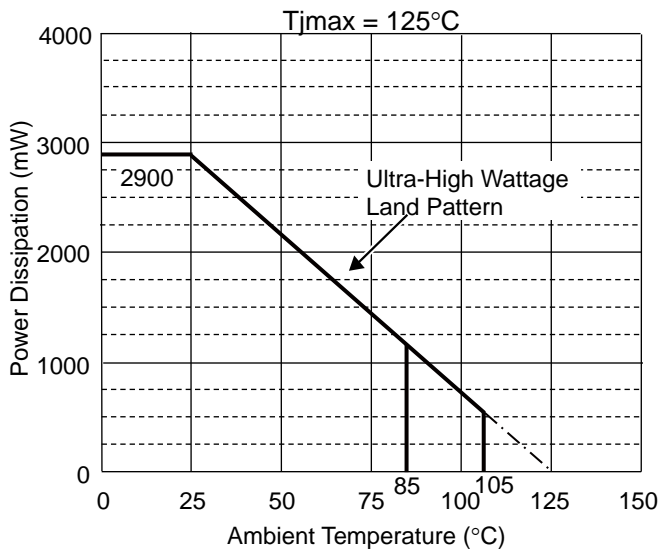
なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

測定条件

超ハイワットテージ実装条件	
測定状態	基板実装状態 (風速 0 m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (4層基板)
基板サイズ	76.2 mm × 114.3 mm × 0.8 mm
配線率	外層 (1層, 4層) : 約 95%, 50 mm 角 内層 (2層, 3層) : 約 100%, 50 mm 角
スルーホール	直径 0.4 mm × 21 個

測定結果 (Ta = 25°C)

超ハイワットテージ実装条件	
許容損失	2900 mW (Tjmax = 125°C) 3600 mW (Tjmax = 150°C)
熱抵抗値	$\theta_{ja} = 35^\circ\text{C/W}$ $\theta_{jc} = 10^\circ\text{C/W}$



許容損失 対 周囲温度

■ 基板パッド推奨寸法

